



2026年3月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）

2025年10月30日

上場会社名 株式会社トーメンデバイス 上場取引所 東
コード番号 2737 URL <https://www.tomendevices.co.jp/>
代表者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）中尾 清隆
問合せ先責任者 （役職名）経理部長 （氏名）原 英記 TEL 03-3536-9150
半期報告書提出予定日 2025年11月13日 配当支払開始予定日 —
決算補足説明資料作成の有無：有
決算説明会開催の有無：有（機関投資家・アナリスト向け）

（百万円未満切捨て）

1. 2026年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（2025年4月1日～2025年9月30日）

（1）連結経営成績（累計）（％表示は、対前年中間期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 中間純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年3月期中間期	243,089	17.3	8,167	36.4	6,997	26.0	4,779	18.8
2025年3月期中間期	207,304	12.8	5,988	5.0	5,552	62.7	4,024	—

（注）包括利益 2026年3月期中間期 4,345百万円（59.3%） 2025年3月期中間期 2,727百万円（36.0%）

	1株当たり 中間純利益	潜在株式調整後 1株当たり 中間純利益
	円 銭	円 銭
2026年3月期中間期	702.77	—
2025年3月期中間期	591.68	—

（2）連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2026年3月期中間期	184,998	51,926	28.1	7,635.23
2025年3月期	113,970	49,621	43.5	7,296.29

（参考）自己資本 2026年3月期中間期 51,926百万円 2025年3月期 49,621百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2025年3月期	—	0.00	—	300.00	300.00
2026年3月期	—	0.00			
2026年3月期（予想）			—	300.00	300.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：有

3. 2026年3月期の連結業績予想（2025年4月1日～2026年3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	470,000	11.5	11,500	13.1	9,000	22.0	6,400	14.5	941.05

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有

※ 注記事項

(1) 当中間期における連結範囲の重要な変更：無

(2) 中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：有

(注) 詳細は、添付資料6ページ「2. 中間連結財務諸表及び主な注記(3) 中間連結財務諸表に関する注記事項(中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記)」をご参照ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更：無
- ② ①以外の会計方針の変更：無
- ③ 会計上の見積りの変更：無
- ④ 修正再表示：無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	2026年3月期中間期	6,802,000株	2025年3月期	6,802,000株
② 期末自己株式数	2026年3月期中間期	1,082株	2025年3月期	1,082株
③ 期中平均株式数(中間期)	2026年3月期中間期	6,800,918株	2025年3月期中間期	6,800,968株

※ 第2四半期(中間期)決算短信は公認会計士又は監査法人のレビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当中間期の経営成績の概況	2
(2) 当中間期の財政状態の概況	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 中間連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 中間連結貸借対照表	3
(2) 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書	4
中間連結損益計算書	4
中間連結包括利益計算書	5
(3) 中間連結財務諸表に関する注記事項	6
(中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記)	6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	6
(継続企業の前提に関する注記)	6
3. 補足情報	7

1. 経営成績等の概況

（1）当中間期の経営成績の概況

当中間連結会計期間における我が国経済は、米国の関税引き上げによる企業収益への影響や物価上昇の長期化による景気減速リスクが顕在化しているものの、底堅い企業収益の改善により景気は緩やかに回復しております。世界経済においては、引き続き、米国の関税政策の動向によるグローバル経済の減速懸念や地政学的リスク、さらには国内外の金利動向による為替変動など、先行き不透明な状況が継続しております。

エレクトロニクス業界におきましては、中国の補助金政策による需要喚起や相互関税引き上げ懸念に対する駆け込み需要に加えて、生成AI（人工知能）関連製品がメモリー需要を牽引しました。

このような状況下、当社グループは、為替相場が昨年に比し円高に推移したものの、主にサーバー・ストレージおよび車載向けメモリー製品の販売数量増加による売上増加と中国スマートフォン向け高精細カメラ用CIS（CMOSイメージセンサー）並びに国内SiP（システム・イン・パッケージ）ビジネスの売上が増加したことから、売上高は2,430億89百万円（前年同期比17.3%増）となりました。また、メモリー製品の価格高騰もあり、収益性の向上に努めたことから、営業利益は81億67百万円（同36.4%増）、経常利益は69億97百万円（同26.0%増）、親会社株主に帰属する中間純利益は47億79百万円（同18.8%増）となりました。

なお、品目別の実績については、7ページの「3. 補足情報（品目別実績）」をご参照ください。

（2）当中間期の財政状態の概況

当中間連結会計期間末の総資産の残高は、1,849億98百万円（前連結会計年度比62.3%増）となりました。これは主に商品、受取手形及び売掛金が増加したことによるものです。

負債の残高は、1,330億71百万円（同106.8%増）となりました。これは主に短期借入金、買掛金が増加したことによるものです。

純資産の残高は、519億26百万円（同4.6%増）となりました。これは主に親会社株主に帰属する中間純利益の計上、配当金の支払によるものです。

（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、生成AI関連製品の需要拡大によりメモリー市場全体で需給が逼迫し、市場価格の上昇が当社売上増加に寄与しました。さらに、市場環境の変化を捉えた販売施策や、供給逼迫下での安定供給の実現により、利益も当初予想を上回る見込みとなりました。これを踏まえ、第2四半期（中間期）の連結業績に基づき、2025年4月24日に発表いたしました通期の連結業績予想を修正いたしました。

詳細につきましては、本日（2025年10月30日）公表いたしました「業績予想および配当予想の修正（増配）に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 中間連結財務諸表及び主な注記

(1) 中間連結貸借対照表

(単位: 百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当中間連結会計期間 (2025年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,801	5,998
受取手形及び売掛金	55,542	83,831
電子記録債権	1,435	496
商品	41,219	85,069
前渡金	629	1,485
預け金	7,371	5,684
その他	703	1,110
流動資産合計	112,703	183,674
固定資産		
有形固定資産	222	267
無形固定資産	264	229
投資その他の資産	780	826
固定資産合計	1,267	1,323
資産合計	113,970	184,998
負債の部		
流動負債		
買掛金	40,649	64,478
未払金	5,488	4,152
短期借入金	14,054	59,641
未払法人税等	1,146	1,946
前受金	1,486	994
賞与引当金	339	138
その他	401	845
流動負債合計	63,566	132,196
固定負債		
退職給付に係る負債	592	567
その他	189	308
固定負債合計	782	875
負債合計	64,349	133,071
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,054	2,054
資本剰余金	16	16
利益剰余金	41,936	44,675
自己株式	△3	△3
株主資本合計	44,003	46,742
その他の包括利益累計額		
繰延ヘッジ損益	90	△264
為替換算調整勘定	5,527	5,447
その他の包括利益累計額合計	5,617	5,183
純資産合計	49,621	51,926
負債純資産合計	113,970	184,998

(2) 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書
(中間連結損益計算書)

(単位: 百万円)

	前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
売上高	207,304	243,089
売上原価	199,303	232,848
売上総利益	8,001	10,240
販売費及び一般管理費	2,012	2,073
営業利益	5,988	8,167
営業外収益		
受取利息	14	22
為替差益	651	—
持分法による投資利益	23	9
その他	7	8
営業外収益合計	696	40
営業外費用		
支払利息	939	852
債権売却損	177	268
為替差損	—	70
その他	16	19
営業外費用合計	1,133	1,210
経常利益	5,552	6,997
特別利益		
償却債権取立益	34	—
特別利益合計	34	—
税金等調整前中間純利益	5,586	6,997
法人税等	1,562	2,218
中間純利益	4,024	4,779
親会社株主に帰属する中間純利益	4,024	4,779

(中間連結包括利益計算書)

(単位: 百万円)

	前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
中間純利益	4,024	4,779
その他の包括利益		
繰延ヘッジ損益	183	△354
為替換算調整勘定	△1,480	△79
その他の包括利益合計	△1,296	△434
中間包括利益	2,727	4,345
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	2,727	4,345

(3) 中間連結財務諸表に関する注記事項

(中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

3. 補足情報 (品目別実績)

品目別		前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)		当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)		増減率 (%)	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)		金額(百万円)	構成比 (%)
	メモリー	171,746	82.9	194,822	80.2	13.4	347,072	82.3
	システムLSI	28,287	13.6	40,701	16.7	43.9	58,448	13.9
半導体小計		200,033	96.5	235,523	96.9	17.7	405,520	96.2
ディスプレイ		5,703	2.8	6,421	2.6	12.6	12,935	3.1
その他		1,568	0.7	1,145	0.5	△27.0	3,216	0.7
合計		207,304	100.0	243,089	100.0	17.3	421,671	100.0

(メモリー)

主にサーバー・ストレージ、車載向けDRAM製品およびNAND FLASH製品の売上が増加したことから、この分野の売上高は1,948億22百万円(前年同期比13.4%増)となりました。

(システムLSI)

中国スマートフォン向け高精細カメラ用CISおよび国内SiPビジネスの売上が増加したことから、この分野の売上高は407億1百万円(同43.9%増)となりました。

(ディスプレイ)

車載およびスマートフォン向けOLED(有機EL)の売上が増加したことから、この分野の売上高は64億21百万円(同12.6%増)となりました。

(その他)

バッテリー製品の売上が増加したものの、LED製品の販売が終息したことから、この分野の売上高は11億45百万円(同27.0%減)となりました。

(ご参考)

「メモリー」に含まれる主な商品は以下のとおりです。

DRAM、NAND FLASH、MCP、SSD(ソリッドステートドライブ)等

「システムLSI」に含まれる主な商品は以下のとおりです。

SoC(システム・オン・チップ)、DDI(ディスプレイドライバーIC)、CIS、

PMIC(パワーマネジメントIC)、SiP、ファウンドリー等

「ディスプレイ」に含まれる主な商品は以下のとおりです。

LCD、OLED等

「その他」に含まれる主な商品は以下のとおりです。

LED、MLCC(積層セラミックコンデンサ)、バッテリー、設備等